



SOITEC INNOVE DANS UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE DES PLAQUES DE SOI

Le « Refresh », un procédé innovant développé dans le cadre du programme de R&D Bernin 2010, qui s'appuie sur la technologie SmartCut™

BERNIN, France — 28 octobre 2008 — Soitec (Euronext Paris), le premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI) et de substrats innovants utilisés en microélectronique a développé le « Refresh », un nouveau procédé de recyclage des plaques de SOI (Silicon On Insulator), opérationnel depuis quelques mois en production.

La technologie Smart-Cut™ possède un avantage déterminant par rapport aux autres techniques de transfert de film : le prélèvement de la couche est non destructif pour le substrat donneur et permet de le recycler pour la réalisation d'une autre série de substrats. C'est un avantage économique crucial dans le cas d'une matière première rare ou coûteuse. Jusqu'ici, Soitec sous-traitait cette activité de recyclage.

Pour répondre aux exigences de performance et de compétitivité du domaine des nanotechnologies, Soitec développe de nouvelles générations de substrats avancés qui nécessitent des ruptures technologiques dans le domaine du recyclage. Soitec a décidé d'accroître son activité industrielle en s'impliquant dans le domaine hautement technologique du recyclage des substrats. Un procédé innovant de recyclages successifs a été mis en œuvre en complément de la technologie Smart-Cut™. Ce procédé est d'ores et déjà mis en œuvre à Bernin et à Pasir Ris pour les produits 300 mm.

La qualité des substrats recyclés par Soitec est aujourd'hui similaire à celle de ses concurrents, qui sont les leaders de la fabrication des plaques de silicium. Avec son procédé de Refresh mis en place en un temps record, Soitec s'approprie une activité de plus en plus stratégique pour son métier. Cela lui permet de réduire ses coûts de fabrication, d'accroître sa compétitivité et de se donner les moyens de se tourner vers les marchés de l'électronique grand public. Le Refresh s'inscrit dans la politique globale de réduction des coûts du groupe, objectif primordial pour Soitec.

Ces développements ont été menés dans le cadre du programme Bernin 2010, avec le soutien des collectivités territoriales et de l'Etat : Conseil Général de l'Isère, Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan (COSI), Ville de Bernin et Direction Générale des Entreprises du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. L'objectif du programme Bernin 2010 est de renforcer sur le site de Bernin, au plus près des équipes de production, les activités de R&D de Soitec pour le développement de nouveaux substrats avancés. Ce projet s'échelonne sur 3 ans (2006-2009) ; il est mené par Soitec, sa division Tracit et le CEA-Léti.

À propos du Groupe Soitec :

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plateforme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Pour toute information, merci de contacter:

Relations Presse – H & B Communication

Mathieu Ferrié – Nadège Chapelin

Tel. 33 (0)1 58 18 32 49 - 45

Email : m.ferrie@hbcommunication.fr